

# [Phantom Gaming: le nuove GPU di AsRock](#)

Come avevamo detto in una precedente [news](#), **AsRock**, noto produttore di schede madri sarebbe entrato nel mercato GPU come partner per **AMD**. Dopo qualche settimana ASRock ha annunciato ufficialmente le sue prime schede grafiche. La famiglia **Phantom Gaming** includerà inizialmente quattro modelli di GPU basati sulle GPU **Radeon serie 500**, rivolgendosi al segmento **mainstream** con cui si potrà comprendere il potenziale che AsRock avrà sul mercato, anche se probabilmente sarà difficile porre una forte concorrenza. La famiglia Phantom Gaming ha a bordo le GPU Polaris 10 e Polaris 11 di AMD: la **Phantom Gaming Radeon RX550 2G**, la **Phantom Gaming Radeon RX560 2G**, la **Phantom Gaming X Radeon RX570 8G OC** e la **Phantom Gaming X Radeon RX580 8G OC**. Le schede verranno spedite con frequenze di *clock* e memoria predefinite, comparabili a quelle raccomandate da AMD, ma tutte supporteranno la **modalità OC**, attivabile utilizzando l'utility di overclock proprietaria ASRock. Tutte le schede grafiche Phantom Gaming si basano su **PCB** e **sistemi di raffreddamento** sviluppati direttamente dalla casa.

Le schede **Radeon RX 570/580** di fascia più alta utilizzano dei dissipatori più efficienti con due ventole e un radiatore in alluminio con una base in rame e tre **heat pipes**. Gli adattatori entry-level **Radeon RX 550/560** sono compatibili con i sistemi **Mini-ITX** e dispongono di radiatori in alluminio e una ventola. Il produttore ha confermato l'utilizzo di tecnologie e materiali premium per massimizzare la durata e l'efficienza dei suoi sistemi di dissipazione. Per aumentare la compatibilità, tutte le schede sono dotate di uscite **DVI-D**, **DisplayPort** e **HDMI** per connettersi a tutti i tipi di display.

Finora ASRock non ha rivelato alcun piano riguardo l'utilizzo delle **GPU Vega**, ma dal momento che sta entrando nel mercato delle schede video per la prima volta, la società è chiaramente un po' cauta. Sul prezzo **non sono state diffuse informazioni** ma, considerando che i prezzi delle GPU tendono al rialzo, non ci si aspetta un allontanamento da questo trend.

**ASRock Phantom Gaming X RX 580 8G OC**

**ASRock Phantom Gaming X RX 570 8G OC**

**ASRock Phantom Gaming RX560 2G**

## AsRock entrerà nel mercato delle schede video?

Secondo fonti di mercato riportate da [Digitimes](#), il produttore di schede madri **ASRock** entrerà nel mercato delle schede grafiche ad aprile e si concentrerà principalmente sulla fornitura di prodotti basati su **AMD**. Con un aumento del fatturato, grazie alla vendita delle schede madri di fascia alta e dei prodotti **IPC** e **server**, ha contribuito a ridurre la dipendenza dal business delle schede madri **consumer**, la cui quota di compartecipazione è scesa a circa il **70% alla fine del 2017**, dall'**85% del 2016**. AsRock quindi è pronta a fare debutto sul mercato delle GPU: Nel 2017, l'azienda ha aumentato la vendita dei propri prodotti principalmente per la riorganizzazione di **Gigabyte Technology**, che ha dato ad ASRock l'opportunità di incrementare significativamente la proporzione di spedizioni di schede madri da fascia **media ad alta**, mentre la forte richiesta di schede madri da **mining** per **criptovalute** ha anche contribuito a migliorare le sue vendite nell'anno. Dal momento che AMD finora non ha mostrato alcun segno di pianificazione per un'espansione della capacità, l'ingresso di ASRock nel mercato delle schede grafiche dovrebbe influenzare la fornitura di GPU di AMD e altri fornitori.

---

## G.Skill rilascia delle nuove RAM da record per la nuova piattaforma X299 Kaby Lake

**G.Skill** è un'azienda da record e si sa, di volta in volta ad ogni nuova versione di RAM che crea cerca di spingere al limite le **frequenze e memory clock da record**. L'ultimo modello delle **G.Skill** infatti è arrivato a livelli dove nessun'altro produttore sembra ancora poter arrivare, così da ottenere il record di memorie più veloci finora prodotte.

**G.Skill rende disponibili memorie DDR4 a 4600 MHz con 1,50 V - Disponibile in kit da 16 GB Fine Tuned per i processori Kaby Lake-X.**

Lanciato alla fine di settembre, il **nuovo kit** di memoria sarà disponibile in **due versioni**: il primo ha un **corpo in alluminio e argento con una barra bianca** mentre la seconda variante con **corpo in**

**alluminio nero con barra nera.** Entrambe le varianti verranno spedite con una capacità massima di **16 GB** in modo che siano **8 GB** per **DIMM** e saranno configurate per funzionare a **4600 MHz CL19**.

Quindi la caratteristica principale è ovviamente l'**imponente velocità del clock** che è un ottimo risultato se paragonato alle alternative che offre il mercato, però ciò significa che ci si avvicina rapidamente ai limiti che le memorie **DDR4** possono dare. Come già visto, la velocità massima ufficiale dello standard di memoria (DDR4) impostata a **3200 MHz** è già esaurita e le aziende come G.Skill stanno sicuramente mostrando alcuni straordinari lavori tecnici per raggiungere **velocità di clock** ancora **più elevate**. Il prossimo standard **DDR5** che dovrebbero essere disponibile sulle piattaforme consumer nei prossimi 2-3 anni mira a raggiungere velocità standard fino a **6400 MHz**, quindi sarà interessante vedere cosa **G.Skill** riesce a fare. Il produttore ha già raggiunto frequenze superiori a **5500 MHz** con la loro serie **Trident Z** in coppia ad un processore **Kaby Lake X** e ha annunciato di lanciare la memoria **DDR4-4800 MHz** in futuro. Le memorie **DDR4-4600** verranno vendute con una tensione di **1,50V**, aumentandola del **25%** rispetto ai **1.20V standard**. Riguardo i **timing** delle DIMM sono veramente allettanti, **CL19 (CL19 23-23-43)** e G.Skill stessa dichiara che questi moduli sono costruiti con componenti selezionati a mano e di alta qualità tra le **Samsung B-die IC** quindi possiamo sicuramente aspettarci che questi siano kit di memoria di qualità molto buona. Infine, **G.Skill** ha eseguito una prova di stabilità della memoria su un **Core i7 7740X** e la **ASRock X299 OC Formula**, che è una scheda madre sorprendente per l'overclocking di un chip Core-X:

## **Trident Z DDR4-4600 MHz CL19-23-23-43 16 GB (2 x 8 GB)**

**In precedenza**, la velocità di 4600 MHz su DDR4 è stata ottenibile solo in caso di **overclock estremo con raffreddamento ad azoto liquido (LN2)**. Ora, progettato per estreme velocità in dual-channel per l'ultima piattaforma desktop di **Intel X299**, **G.SKILL** è ancora una volta alzare i limiti della velocità di memoria DDR4 a 4600 MHz CL19-23-23-43 con 1.50V e una capacità totale di 16 GB (2 x 8 GB).

## **Supporto e disponibilità a Intel XMP 2.0**

Questo nuovo kit **Trident Z** ad alte prestazioni è stato progettato con supporto a **Intel XMP 2.0** e le due varianti del kit di memoria **Trident Z DDR4-4600 MHz** sono previste per la distribuzione **tramite i partner di distribuzione autorizzati G.SKILL** alla fine di settembre 2017. Per altre informazioni è possibile consultare il sito [G.Skill](http://G.Skill).

---

## **[Intel: l'8° Gen dei Core i3 sarà un quad core con HyperThreading ?](#)**

Alcuni giorni fa sul famoso forum [NGA Forum China](#), l'utente **Baidu** ha cominciato a far circolare leak sulle future cpu di fascia bassa targate **Intel**, ovvero l'**i3-8300**. Questo sembrerebbe non solo

avere 4 core, ma anche l'HyperThreading. Baidu non è visto come un informatore molto attendibile ma un'altra fonte, [PC EVA](#), ha confermato il leak dell'insider.

## L'ottava generazione dei Core i3, i5 e i7

Intel sta scuotendo il mercato **CPU** con i processori mainstream **Coffee Lake** di 8 ° generazione, i **Quad Core** i3 e **Hexa Core** i5 e i7, **non compatibili** con **LGA 1151**. Prima di approfondire i particolari della notizia chiariamo alcune cose: come la maggior parte di voi saprà, la linea commerciale Intel - senza contare **HEDT** - è stata divisa in Core i3, Core i5 e Core i7. I Core i3 sono tradizionalmente CPU con Hyper Threading abilitato per **2 core fisici** e **4 core logici**. I Core i5 sono dei quad core con Hyper Threading disabilitato per **4 core fisici** e **4 core logici**. Infine, i Core i7 sono quad core con Hyper Threading abilitati quindi **4 core fisici** e **8 core logici**. Questa è una progressione logica delle prestazioni che è stata messa in atto però per poche generazioni.

Purtroppo per Intel, **AMD** ha rotto, dopo **sette** lunghissimi anni, il silenzio nel campo delle CPU **x86** rilasciando sul mercato nuovi prodotti sviluppati attorno alla sua nuova architettura **Zen**, architettura che sembra potrà rendere la società molto competitiva sul mercato dando (a favore della libera competizione) del filo da torcere a Intel. AMD ha infatti lanciato i processori come il **Ryzen 1200** con **4 core fisici** e **4 core** logici ad un competitivo prezzo di soli **109 euro**, il tradizionale **Core i3** ha perso quasi tutte le ragioni di esistenza sul mercato. Il **dual core** Intel Core i3 7100 ha solo **2 core fisici** e costa **15 euro** in più del quad core di **Ryzen**. Il quad core Intel **Core i5 7400** dispone di **4 core fisici** e costa **70 euro** in più rispetto alla controparte AMD. In altre parole, Ryzen ha reso la linea **entry level** e **mid range** di Intel veramente poco competitiva nel rapporto prezzo/prestazionale, quindi la società di Santa Clara si appresta a rispondere. Le CPU dual core si apprestano ormai ad essere **obsolete** ed Intel sembra esserne a conoscenza tanto che nella sua prossima generazione di processori denominata Coffee Lake, l'entry level Core i3-8300 sembra che disporrà di **4 Core** e **8 Threads**. Quindi cosa lo differenzia dal Core i5? Sappiamo che variante i3 non sarà dotata della tecnologia Turbo Boost in modo che il processore funzioni al massimo della frequenza che dispone. Quindi una possibilità per le varianti i5 potrebbe essere **6 core fisici** ma con l'Hyper Threading disabilitato per differenziarla dalla linea i7, anche se alcune **SKU** consentiranno anche l'**overclocking spinto**. Ma allora cosa succede con i7? L'8a generazione Coffee Lake Core i7 non solo ha **6 core fisici** ma anche **6 core logici** per un totale complessivo di **12 thread**. Di seguito sono riportate le specifiche complete della linea:

La fonte ha anche rivelato la linea temporale per i processori:

- La produzione di massa dei PCH Coffee Lake è iniziata dai primi di agosto e viene elencata in ottobre.
- Gli Engineering Sample di Cannonlake PCH sono stati tolti dalla vendita alla fine di luglio di quest'anno, a novembre inizierà la produzione di massa dei QS che usciranno entro gennaio del prossimo anno, con la quotazione entro la fine di febbraio 2018.
- Gennaio 2018, le serie 200 e H110 saranno tolte dalla produzione e sostituite da Coffee Lake-S.

Una conferma da parte di **ASRock** ha anche rivelato che Intel non sarà in grado di supportare i processori Coffee Lake sul chipset serie 200. Ciò significa che la nuova piattaforma **Z270 Skylake** non sarà in grado di supportare le offerte di Intel **Coffee Lake**. Anche se questo lo abbiamo già visto da **Intel** per un bel po' di tempo, le cose dovrebbero cambiare a causa del monopolio della società che viene rotto con Zen. Tuttavia, questo non sembra essere il caso per quanto riguarda la gestione

di Intel. Poiché i processori Intel di 8° Generazione non funzioneranno sul socket **LGA 1151**, ciò significherebbe che le schede madri serie 100 e 200 non supportino i processori basati su Coffee Lake-S. Questo include i 6 core fino alla parte **Celeron**. Mentre è stato originariamente pensato che il supporto potrebbe essere incluso, si pensa che Intel sta lavorando su un nuovo socket **LGA 1151 v2** che, pur avendo lo **stesso numero di pin** non permetterà la retro compatibilità con il vecchio LGA 1151. Quindi questo nuovo LGA 1151 sarà la nuova **serie 300**. Ad ogni modo Intel sembra molto fiduciosa delle proprie scelte di mercato. AMD al contrario ha sempre avuto una filosofia di primo consumo molto aggressiva, mentre Intel può essere dichiarato solo come un netto contrasto con lo stesso. Dal momento che **il socket è praticamente lo stesso** per tutti gli scopi, la non compatibilità sarà causata da un **“blocco”** tramite il **microcode** a limitare la compatibilità all'indietro, possiamo quindi solo supporre che Intel sta facendo questo per stimolare più vendite. Intel non si rende conto su che minaccia sia l'architettura Zen di AMD che fino adesso sta facendo le mosse giuste per poter contrastare Intel.

La serie Coffee Lake-S avrà due varianti, **4 + 2** (Quad Core + GT2 Graphics) e **6 + 2** (Hexa Core + GT2 Graphics). La variante 4 + 2 avrà una dimensione di **126mm<sup>2</sup>** mentre la variante 6 + 2 avrà una dimensione di **149mm<sup>2</sup>** che è la stessa delle future varianti di Coffee Lake X. La grafica sarà la stessa della **9° Gen** con **24 EU** e la variante più potente sarà chiamata **UHD Graphics 730**. Una delle notizie trapelate più interessanti è stato il diagramma a blocchi **CNL-PCH** che descrive i processori di serie Lake Lake-S e Coffee Lake-H. Intel manterrà intatto il supporto sul CNL-PCH. Sul nuovo chipset significa che Intel ha dato la possibilità di cambiare il socket e considerando la struttura inusuale della matrice e successivamente il supporto per i processori da **10 nm**, ci si può aspettare che ciò accada. LGA 1151 avrà già servito due generazioni di processori da allora, Skylake e Kaby Lake. A partire dai dettagli, abbiamo i processori della serie Coffee Lake-S / H in grado di supportare la memoria **DDR4 2400 MHz** nativa in modalità dual channel. Le GPU su questi chip consentono il supporto per la connettività **DP 1.2** a **HDMI 2.0** e **HDCP 2.2**. Ci sono anche diverse linee **x16 PCIe Gen 3.0** che possono essere utilizzate per alimentare schede grafiche discrete e pannelli **eDP** per una maggiore velocità delle immagini. Il PCH Cannonlake serie 300 dispone di due controller **Alpine Ridge** per fino a **4 porte USB Type-C**. Non sappiamo l'esatta quantità di piste **PCIe** offerte dal PCH ma sembrano tante. Le linee **PCIe 3.0** offrono **due slot M.2** per il supporto **Optane/SSD**. Un slot **PCIe 3.0 x4** e **3.0 x1** è alimentato anche dal PCH, ma c'è anche un **lettore SD Card**. L' **I/O** comprende anche la porta **Ethernet GbE PHY**, il **sensore di impronte digitali**, **NFC**, **codec**, **touch screen**, **6 porte Type A/C USB 3.1**, **fotocamera UF**, **ODD**, **HDD 2x SATA 3** e il controller **Douglas Peak** che offre **WiGig** + Supporto **Wi-Fi** + **BT**.